

●USPN-4 パッケージ許容損失

USPN-4 パッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

1. 測定条件(参考データ)

測定条件：基板実装状態

雰囲気：自然対流

実装：Pb フリーはんだ

実装基盤：基板 40mm×40mm (片面 1600mm²) に対して

銅箔面積 表面 約 50%-裏面 約 50%

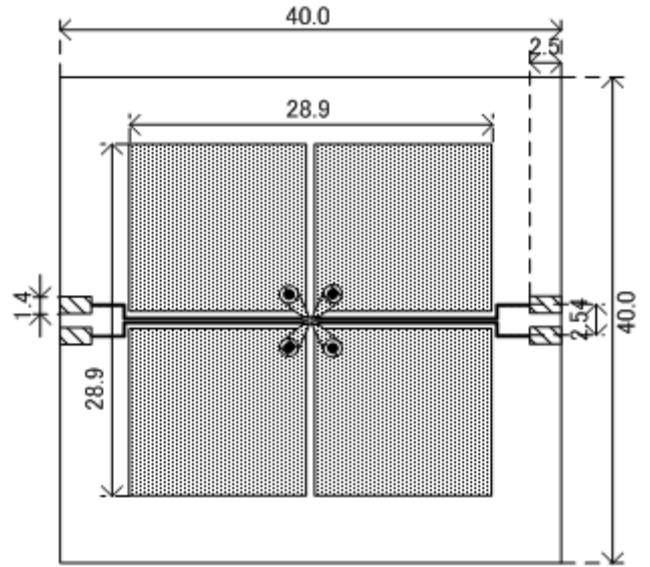
各リードと銅箔接続

(各リード 表面 約 12.5%-裏面 約 12.5%の銅箔と接続)

基板材質：ガラスエポキシ (FR-4)

板厚：1.6mm

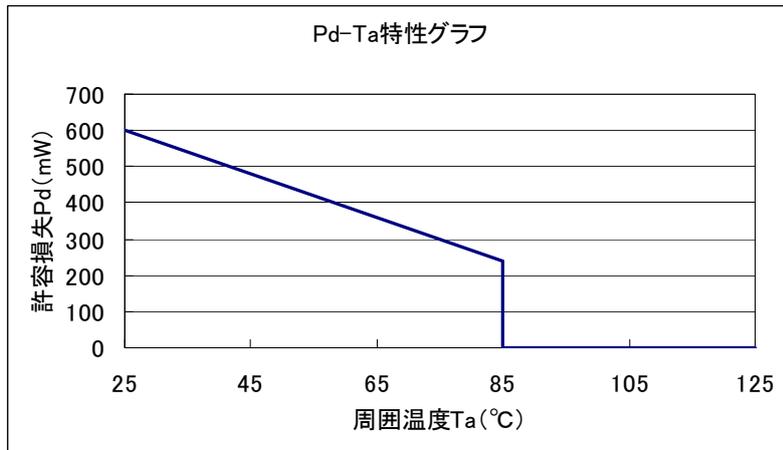
スルーホール：ホール径 0.8mm 4個



2. 許容損失-周囲温度特性(85°C保証品)

基板実装(T_{Jmax}=125°C)

周囲温度(°C)	許容損失 Pd (mW)	熱抵抗(°C/W)
25	600	166.67
85	240	



3. 許容損失-周囲温度特性(105°C保証品)

周囲温度(°C)	許容損失 Pd (mW)	熱抵抗(°C/W)
25	600	166.67
105	120	

